

2025-2030年中国集成电路封装行业“专精特新”发展研究及投资战略规划报告

目 录

CONTENTS

第1章：中国集成电路封装行业“专精特新”发展概述

1.1 集成电路封装行业的界定

- 1.1.1 集成电路封装的界定
- 1.1.2 集成电路封装所处产业链环节
- 1.1.3 集成电路封装行业分类
- 1.1.4 集成电路封装所属国民经济行业分类

1.2 “专精特新”概念界定

- 1.2.1 “专精特新”概念解读
- 1.2.2 “专精特新”相关概念辨析
 - (1) 专精特新“小巨人”
 - (2) 专精特新中小企业
 - (3) 其他相关概念辨析

1.3 “专精特新”发展背景及发展地位分析

- 1.3.1 “专精特新”发展背景-内因分析
 - (1) 中国中小企业发展现状
 - (2) 中国制造业发展现状
 - (3) 服务“国内国际双循环”发展格局
- 1.3.2 “专精特新”发展背景-外因分析
 - (1) 全球贸易摩擦加剧、外部环境动荡
 - (2) 中国高科技发展遭遇“卡脖子”
- 1.3.3 “专精特新”发展地位分析

1.4 本报告研究范围界定说明

1.5 本报告数据来源及统计标准说明

第2章：全球及中国集成电路封装行业发展现状分析

2.1 全球集成电路封装行业发展现状

- 2.1.1 全球集成电路封装行业发展规模
- 2.1.2 全球集成电路封装行业区域发展格局
- 2.1.3 全球集成电路封装行业企业竞争格局

2.2 中国集成电路封装行业发展现状

- 2.2.1 中国集成电路封装行业发展规模
- 2.2.2 中国集成电路封装行业区域发展格局
- 2.2.3 中国集成电路封装行业企业竞争格局

2.3 中国集成电路封装行业技术水平及国产化现状

- 2.3.1 中国集成电路封装行业技术发展现状
 - (1) 集成电路封装行业技术创新现状
 - (2) 集成电路封装行业专利申请情况
 - (3) 集成电路封装行业技术研发趋势
- 2.3.2 中国集成电路封装行业国产化发展现状
 - (1) 集成电路封装行业国产化率分析
 - (2) 集成电路封装行业本土企业布局

2.4 中国集成电路封装行业发展机遇与挑战分析

第3章：中国集成电路封装行业“专精特新”政策环境及投融资环境分析

3.1 中国集成电路封装行业“专精特新”政策环境分析

- 3.1.1 国家层面集成电路封装行业发展相关政策及规划汇总解读
 - (1) 集成电路封装行业发展相关政策汇总
 - (2) 集成电路封装行业发展相关规划汇总
- 3.1.2 国家层面集成电路封装行业“专精特新”相关政策汇总解读
- 3.1.3 国家“十四五”规划对集成电路封装行业发展的影响分析
- 3.1.4 “国内国际双循环”战略的提出对集成电路封装行业的影响分析

- 3.1.5 集成电路封装行业“专精特新”发展的政策机遇分析
 - 3.2 中国集成电路封装行业“专精特新”投融资环境分析
 - 3.2.1 中国集成电路封装行业“专精特新”领域主要资金来源
 - 3.2.2 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资主体
 - 3.2.3 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资方式
 - 3.2.4 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资事件汇总
 - 3.2.5 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投融资机遇分析
 - (1) 集成电路封装行业“专精特新”财税扶持力度
 - (2) 集成电路封装行业“专精特新”信贷支持政策
 - (3) 集成电路封装行业“专精特新”市场化融资渠道
 - (4) 北京交易所成立带来的发展机遇分析
 - 3.3 中国集成电路封装行业“专精特新”发展战略支撑及保障
- 第4章：中国集成电路封装行业“专精特新”企业培育方案及培育现状解读**
- 4.1 中国集成电路封装行业“专精特新”企业培育方案解读
 - 4.1.1 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育目的
 - 4.1.2 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育对象
 - 4.1.3 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育内容
 - 4.1.4 集成电路封装行业国家级“专精特新”企业培育措施
 - 4.1.5 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业奖励标准
 - 4.2 中国集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报条件及流程解读
 - 4.2.1 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报-基本条件
 - 4.2.2 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报-专项条件
 - 4.2.3 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报-分类条件
 - 4.2.4 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业申报流程解读
 - 4.3 中国集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育现状分析
 - 4.3.1 全国专精特新“小巨人”企业培育现状
 - (1) 专精特新“小巨人”企业培育进展
 - (2) 专精特新“小巨人”企业培育特征
 - (3) 专精特新“小巨人”企业行业分布
 - 4.3.2 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育现状
 - (1) 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育进展
 - (2) 集成电路封装行业专精特新“小巨人”企业培育特征
- 第5章：中国集成电路封装产业链全景梳理及“专精特新”鼓励布局方向**
- 5.1 中国集成电路封装产业结构属性（产业链）分析
 - 5.1.1 中国集成电路封装产业链结构梳理
 - 5.1.2 中国集成电路封装产业链生态图谱
 - 5.2 中国集成电路封装产业价值属性（价值链）分析
 - 5.2.1 中国集成电路封装行业成本结构分析
 - 5.2.2 中国集成电路封装行业价值链分析
 - 5.3 中国集成电路封装行业发展痛点分析
 - 5.4 中国集成电路封装产业链“专精特新”鼓励布局方向
- 第6章：中国集成电路封装产业链环节“专精特新”布局状况研究**
- 6.1 中国集成电路封装行业之先进封装材料“专精特新”布局状况研究
 - 6.1.1 中国集成电路封装行业之先进封装材料发展现状分析
 - (1) 先进封装材料市场发展规模
 - (2) 先进封装材料技术发展现状
 - (3) 先进封装材料国产化发展现状
 - 6.1.2 中国集成电路封装行业之先进封装材料发展痛点分析
 - 6.1.3 中国集成电路封装行业之先进封装材料“专精特新”市场培育现状
 - 6.1.4 中国集成电路封装行业之先进封装材料市场竞争格局分析
 - 6.1.5 中国集成电路封装行业之先进封装材料发展前景及趋势分析
 - 6.2 中国集成电路封装行业之封测设备“专精特新”布局状况研究
 - 6.2.1 中国集成电路封装行业之封测设备发展现状分析
 - (1) 封测设备市场发展规模
 - (2) 封测设备技术发展现状
 - (3) 封测设备国产化发展现状
 - 6.2.2 中国集成电路封装行业之封测设备发展痛点分析
 - 6.2.3 中国集成电路封装行业之封测设备“专精特新”市场培育现状
 - 6.2.4 中国集成电路封装行业之封测设备市场竞争格局分析

- 6.2.5 中国集成电路封装行业之封测设备发展前景及趋势分析
- 6.3 中国集成电路封装行业之SIP封装“专精特新”布局状况研究**
 - 6.3.1 中国集成电路封装行业之SIP封装发展现状分析
 - (1) SIP封装市场发展规模
 - (2) SIP封装技术发展现状
 - (3) SIP封装国产化发展现状
 - 6.3.2 中国集成电路封装行业之SIP封装发展痛点分析
 - 6.3.3 中国集成电路封装行业之SIP封装“专精特新”市场培育现状
 - 6.3.4 中国集成电路封装行业之SIP封装市场竞争格局分析
 - 6.3.5 中国集成电路封装行业之SIP封装发展前景及趋势分析
- 6.4 中国集成电路封装行业之WLCSP封装“专精特新”布局状况研究**
 - 6.4.1 中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展现状分析
 - (1) WLCSP封装市场发展规模
 - (2) WLCSP封装技术发展现状
 - (3) WLCSP封装国产化发展现状
 - 6.4.2 中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展痛点分析
 - 6.4.3 中国集成电路封装行业之WLCSP封装“专精特新”市场培育现状
 - 6.4.4 中国集成电路封装行业之WLCSP封装市场竞争格局分析
 - 6.4.5 中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展前景及趋势分析
- 第7章：中国集成电路封装行业区域发展格局及“专精特新”发展研究**
 - 7.1 中国集成电路封装产业资源区域分布状况**
 - 7.2 中国集成电路封装行业企业数量区域分布**
 - 7.3 中国集成电路封装行业区域发展格局分析**
 - 7.4 中国各省市集成电路封装行业“专精特新”政策环境分析**
 - 7.5 中国各省市集成电路封装行业“专精特新”企业培育方案及申报条件**
 - 7.5.1 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业培育方案解读
 - (1) 省级“专精特新”企业培育方案解读
 - (2) 市级“专精特新”企业培育方案解读
 - 7.5.2 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业奖励标准
 - 7.5.3 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业申报条件解读
 - (1) 省级“专精特新”企业申报条件
 - (2) 市级“专精特新”企业申报条件
 - 7.5.4 集成电路封装行业省市级“专精特新”企业申报流程解读
 - (1) 省级“专精特新”企业申报流程
 - (2) 市级“专精特新”企业申报流程
 - 7.6 中国各省市集成电路封装行业“专精特新”市场培育现状**
 - 7.6.1 各省市集成电路封装行业“专精特新”企业培育规模
 - 7.6.2 各省市集成电路封装行业“专精特新”市场培育格局
 - 7.6.3 各省市集成电路封装行业“专精特新”市场培育特征
- 第8章：中国集成电路封装行业代表性“小巨人”企业布局对比及案例研究**
 - 8.1 中国集成电路封装行业代表性“小巨人”企业布局对比**
 - 8.2 中国集成电路封装行业代表性“小巨人”企业布局案例研究**
 - 8.2.1 企业一
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
 - (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
 - (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析
 - 8.2.2 企业二
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况
 - (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
 - (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
 - (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
 - (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析
 - 8.2.3 企业三
 - (1) 企业发展历程及基本信息
 - (2) 企业发展状况

- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.4 企业四

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.5 企业五

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.6 企业六

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.7 企业七

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.8 企业八

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.9 企业九

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

8.2.10 企业十

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业集成电路封装业务类型及产品介绍
- (4) 企业集成电路封装产业链布局状况
- (5) 企业集成电路封装业务“专精特新”布局动向
- (6) 企业集成电路封装业务布局优劣势分析

第9章：中国集成电路封装行业“专精特新”发展趋势预判及前景预测

9.1 中国集成电路封装行业市场前景预测

9.2 中国集成电路封装行业“专精特新”发展趋势预判

9.3 中国集成电路封装行业“专精特新”发展前景预测

第10章：中国集成电路封装行业“专精特新”投资特性及投资机会分析

10.1 中国集成电路封装行业“专精特新”投资特性分析

- 10.1.1 中国集成电路封装行业“专精特新”投资壁垒分析
 - 10.1.2 中国集成电路封装行业“专精特新”投资风险预警及防范
 - 10.2 中国集成电路封装行业“专精特新”投资价值评估
 - 10.3 中国集成电路封装行业“专精特新”投资机会分析
 - 10.3.1 产业链薄弱环节投资机会
 - 10.3.2 区域市场投资机会
 - 10.3.3 细分市场投资机会
 - 10.4 中国集成电路封装行业“专精特新”潜在发展方向分析
- 第11章：中国集成电路封装行业“专精特新”投资策略及发展建议**
- 11.1 中国集成电路封装行业“专精特新”投资策略
 - 11.2 中国集成电路封装行业“专精特新”发展建议

图表目录

- 图表1：中国集成电路封装行业本土企业布局情况
- 图表2：中国集成电路封装行业发展机遇与挑战分析
- 图表3：截至2024年中国集成电路封装行业发展政策汇总-国家层面
- 图表4：截至2024年中国集成电路封装行业发展规划汇总-国家层面
- 图表5：截至2024年中国集成电路封装行业“专精特新”发展政策解读-国家层面
- 图表6：中国集成电路封装行业发展痛点分析
- 图表7：中国集成电路封装行业先进封装材料本土企业布局情况
- 图表8：中国集成电路封装行业先进封装材料市场发展痛点分析
- 图表9：中国集成电路封装行业之封测设备本土企业布局情况
- 图表10：中国集成电路封装行业之封测设备发展痛点分析
- 图表11：中国集成电路封装行业之SIP封装本土企业布局情况
- 图表12：中国集成电路封装行业之SIP封装发展痛点分析
- 图表13：中国集成电路封装行业之WLCSP封装本土企业布局情况
- 图表14：中国集成电路封装行业之WLCSP封装发展痛点分析
- 图表15：企业一发展历程
- 图表16：企业一基本信息表
- 图表17：企业一股权穿透图
- 图表18：企业一经营状况
- 图表19：企业一整体业务架构
- 图表20：企业一销售网络布局
- 图表21：企业一集成电路封装业务布局优劣势分析
- 图表22：企业二发展历程
- 图表23：企业二基本信息表
- 图表24：企业二股权穿透图
- 图表25：企业二经营状况
- 图表26：企业二整体业务架构
- 图表27：企业二销售网络布局
- 图表28：企业二集成电路封装业务布局优劣势分析
- 图表29：企业三发展历程
- 图表30：企业三基本信息表
- 图表31：企业三股权穿透图
- 图表32：企业三经营状况
- 图表33：企业三整体业务架构
- 图表34：企业三销售网络布局
- 图表35：企业三集成电路封装业务布局优劣势分析
- 图表36：企业四发展历程
- 图表37：企业四基本信息表
- 图表38：企业四股权穿透图
- 图表39：企业四经营状况
- 图表40：企业四整体业务架构
- 图表41：企业四销售网络布局
- 图表42：企业四集成电路封装业务布局优劣势分析

图表43: 企业五发展历程
图表44: 企业五基本信息表
图表45: 企业五股权穿透图
图表46: 企业五经营状况
图表47: 企业五整体业务架构
图表48: 企业五销售网络布局
图表49: 企业五集成电路封装业务布局优劣势分析
图表50: 企业六发展历程
图表51: 企业六基本信息表
图表52: 企业六股权穿透图
图表53: 企业六经营状况
图表54: 企业六整体业务架构
图表55: 企业六销售网络布局
图表56: 企业六集成电路封装业务布局优劣势分析
图表57: 企业七发展历程
图表58: 企业七基本信息表
图表59: 企业七股权穿透图
图表60: 企业七经营状况
图表61: 企业七整体业务架构
图表62: 企业七销售网络布局
图表63: 企业七集成电路封装业务布局优劣势分析
图表64: 企业八发展历程
图表65: 企业八基本信息表
图表66: 企业八股权穿透图
图表67: 企业八经营状况
图表68: 企业八整体业务架构
图表69: 企业八销售网络布局
图表70: 企业八集成电路封装业务布局优劣势分析
图表71: 企业九发展历程
图表72: 企业九基本信息表
图表73: 企业九股权穿透图
图表74: 企业九经营状况
图表75: 企业九整体业务架构
图表76: 企业九销售网络布局
图表77: 企业九集成电路封装业务布局优劣势分析
图表78: 企业十发展历程
图表79: 企业十基本信息表
图表80: 企业十股权穿透图
图表81: 企业十经营状况
图表82: 企业十整体业务架构
图表83: 企业十销售网络布局
图表84: 企业十集成电路封装业务布局优劣势分析
图表85: 中国集成电路封装行业“专精特新”领域投资价值评估
如需完整目录请联系客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！